

Analyse von Material- und Prozesseinflüssen auf die Reflowqualität – Teil 2



Zur Untersuchung des Einflusses von Material- und Prozesseinflüssen auf die Reflowqualität wurden drei statistisch geplante Versuchsreihen durchgeführt. Ausgewertet wurden die Benetzungsqualität, die Anzahl von Grabsteinen und Lotperlen, der Standoff sowie der Voidanteil. Es ergibt sich kein einheitliches Bild, da z.B. das Verhalten von BGAs und Siliziumchips sehr unterschiedlich ist. Somit sind individuelle Qualifizierungen zwingend notwendig. // In order to study the effects of materials and process parameters on solder reflow quality, three sets of statistically-planned experiments were carried out. These included wetting quality, the number of tomb-stones and solder pearls and stand-off and void fraction. No simple picture emerges and thus, for example, the behaviour of BGA's and silicon chips is very different. It follows that there is an urgent requirement for specific qualification procedures.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 4,39 €

4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)